

## Technisches Datenblatt

Version 2

Seite 1/1  
Handelsname INWEG-WLC (Wärmeleitpaste)

Druckdatum: 02.05.2018  
überarbeitet am: 29.04.2018

### Anwendungsbeispiele

- Optimiert Wärmeleitung zwischen elektronischen Bauelementen und Kühlkörpern mit geringer bis mittlerer Leistungsdichte wie z. B. Halbleiter (Transistoren, Dioden, Thyristoren usw.) sowie andere integrierte Bauteile

### Eigenschaften

- Frei von Silikonen
- Vermeidet Luft einschließen mit schlechter Wärmeleitung
- Sehr gutes Tieftemperaturverhalten

### Typische Kenndaten

- Einsatztemperatur: -40 °C bis +150 °C
- Aussehen: weißgrau
- NLGI-Klasse: 2 – 3\*

Dickungsmittel	Bentonit/Metalloxide		
Ruhpenetration	1/10 mm	250 - 290	DIN ISO 2137
Wärmeleitfähigkeit bei 25 °C	W/mK	ca. 0,5	Methode PTB**
Ölabscheidung (40 °C/168 h)	%	≤ 2	DIN 51817
Fließdruck bei +20 °C	mbar	≤ 200	DIN 51805
Grundöl	Synthetischer Ester		
Kin. Viskosität bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	ca. 90	DIN 51562
Kin. Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	ca. 13	DIN 51562

### Gebrauchshinweise

- Produkt sollte innerhalb von 6 Monaten ab Produktionsdatum weiterverarbeitet bzw. aufgebraucht sein
- Vor Serieneinsatz wird eine Produktverträglichkeitsprüfung empfohlen
- Nur für Bauteile ohne Hochfrequenzbeanspruchung

\* Angabe bezieht sich auf Ruhpenetration

\*\* Physikalisch Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin (Heizbrückenverfahren)